



La Raise3D E2 est une imprimante 3D professionnelle FDM. Polyvalente et puissante, elle est capable d'imprimer des prototypes de très grandes précisions et de volumes confortables (330x240x240mm).

La Raise3D E2 est équipée d'un système à double extrusion indépendante (IDEX). Ce système augmente sa capacité de production grâce à ses modes d'impressions en duplication ou en miroir. La Raise E2 permet aussi l'impression classique en double extrusion pour la mise en œuvre de deux matériaux différents (support et polymère) ou des impressions bicolores.

Dotée d'une mise en pause automatique et d'une structure complètement fermée, la E2 est une imprimante sûre et fiable, idéale pour le secteur de l'éducation (écoles, lycées...).

Grâce à un écran tactile de 7 pouces doté d'une interface utilisateur très intuitive, d'interfaces réseau (wifi et RJ45), d'une webcam en standard et surtout d'un logiciel de tranchage à la fois facile et performant, la E2 s'intégrera aisément dans la plupart des environnements de travail avec un temps de prise en main réduit.

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis ou un complément d'information.

**Volume maxi impression**

Simple extrusion: 330 x 240 x 240 mm
Double extrusion: 295 x 240 x 240mm

**Températures maxi**

Buses : 300°C
Plateau : 110°C

**Epaisseur de couche mini :**

0.02mm

**Matériaux non propriétaires**

Grande variété de filaments 1,75mm



		RAISED3D E2	
Eléments		Simple extrusion	Double extrusion
Construction	Volume impression	330x240x240 mm	295x240x240 mm
	Dimension extérieure	607x596x465 mm	
	Poids net	35kg	
Alimentation	Alimentation en entrée	100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V @ 2A	
	Alimentation en sortie	24 V DC, 350W	
Imprimante 3D	Technologie d'impression	FDM	
	Tête d'impression	Doubles extrudeurs indépendants	
	Diamètre filament	1.75	
	Pas X /Y/Z	0.78125 , 0.78125 , 0.078125 micron	
	Vitesse de Déplacement tête d'impression	30-150 mm/s	
	Plateau	Plateau en acier flexible avec surface Buildtak	
	Température max du plateau	110°C	
	Matériau du lit chauffant	Silicone	
	Mise à niveau du plateau	Nivellement par maillage avec contrôle de la planéité	
	Matériaux	PLA/ABS/HIPS/PC/TPU/TPE/NYLON/PETG/ASA/PP/PVA...	
	Diamètres de buses	0,4 mm (Par défaut), 0,2 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm	
	Température maxi des buses	300°C	
	Connectivité	Wi-Fi, LAN, Port USB, Caméra en direct	
Niveau sonore	<50 dB(A) en cours d'impression		
Température ambiante de fonctionnement	15-30°C, 10-90% HR sans condensation		
Certifications	CB, CE, FCC, RoHS, RCM		
Logiciel	Logiciel de tranchage (slicer)	ideaMaker	
	Types de fichiers pris en charge	STL / OBJ / 3MF	
	Support OS	Windows / macOS / Linux	
	Type de code machine	GCODE	
Contrôleur d'impression	Interface utilisateur	Ecran tactile 7 pouces (17,8cm)	
	Réseau	Wi-Fi, Etherne	
	Reprise de l'impression après interruption	Sauvegarde firmware, aucune batterie nécessaire	
	Résolution écran	1024x600p	
	Contrôleur de mouvement	Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU	
	Contrôleur logique	NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz	
	Mémoire interne	1 Go	
	Mémoire Flash embarqué	8 Go	
	OS	Linux embarqué	
	Ports	USB 2.0 x2 , Ethernet x1	